

AMD Ryzen 9 9900X3D processor



Artikel	140612
Herstellernummer	100-100001368WOF
EAN	0730143315579
AMD	

Zusammenfassung

AMD Ryzen 9 9900X3D, AMD Ryzen™ 9, Emplacement AM5, 4 nm, Boîte, AMD, 9900X3D

AMD Ryzen 9 9900X3D. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 9, Socket de processeur (réceptacle de processeur): Emplacement AM5, Lithographie du processeur: 4 nm. Canaux de mémoire: Double canal, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 192 Go, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR5-SDRAM. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Graphics, Fréquence de base de carte graphique intégrée: 2200 MHz. Segment de marché: Bureau, Set d'instructions pris en charge: AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3

Merkmale

Conditions environnementales

Température minimale de fonctionnement	95 °C
--	-------

Caractéristiques

Segment de marché	Bureau
Nombre maximum de voies PCI Express	28
Version des emplacements PCI Express	5.0
Set d'instructions pris en charge	AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3

Mémoire

Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	192 Go
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR5-SDRAM
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	3600,5600 MHz
Canaux de mémoire	Double canal
ECC	Oui

Processeur

Fabricant de processeur	AMD
Génération de processeurs	AMD Ryzen 9000 Series
Modèle de processeur	9900X3D
Fréquence de base du	4,4 GHz

Graphique

Carte graphique intégrée	Oui
Adaptateur de carte graphique distinct	Non
Modèle d'adaptateur graphique inclus	AMD Radeon Graphics
Fréquence de base de carte graphique intégrée	2200 MHz
Modèle d'adaptateur graphique distinct	Indisponible

processeur	
Famille de processeur	AMD Ryzen™ 9
Nombre de coeurs de processeurs	12
Socket de processeur (réceptable de processeur)	
Emplacement AM5	
Lithographie du processeur	4 nm
Nombre de threads du processeur	24
Modes de fonctionnement du processeur	
64-bit	
Fréquence du processeur Turbo	5,5 GHz
Mémoire cache du processeur	140 Mo
Type de cache de processeur	L2 & L3
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	120 W
Type d'emballage	Boîte
Refroidisseur inclus	Non

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.